

MXM 3.1 GPUモジュール拡張可能な 組み込みGPUコンピューター

EDG-GM1000は、MXM GPUモジュールやCMI(Combined Multiple I/O)など、専用の様々なモジュールを組み込むことで現場に最適なソリューションを提供することが可能です。

あらかじめ決められた構成のコンピューターとは違い、各種モジュールを交換するだけで幅広い用途をサポート。無駄なコストを省きつつ、運用環境に合わせた柔軟な対応ができます。

「MXMモジュール」とは

GPUの換装やアップグレードを可能とするビデオ拡張インターフェイス。コンパクトなファンレス筐体との親和性も高く、屋外の交通/インフラ施設や粉塵の多い工場施設などの厳しい環境でもGPUを搭載したエッジコンピューティング運用が可能になります。



EDG-GM1000

- 最大8コアの第8/第9世代 インテル® Xeon® / Core™ プロセッサ搭載可能
- 1x MXM3.1タイプA / BフォームファクターGPUモジュール拡張が可能
- 最大64GBのデュアルDDR4-2666SO-DIMMメモリを搭載可能
- 広い動作温度(-40℃~+70℃)と振動/衝撃耐性(5G~50G)
- 幅260 mm x 奥行200 mm x 高さ85mmのコンパクトな筐体



製品仕様

型番	EDG-GM1000	
プロセッサ	種類	インテル® Xeon® E プロセッサファミリー Xeon®E-2278GE, Xeon®E-2278GEL, Xeon®E-2176G, Xeon®E-2124G 第9世代インテル® Core™ プロセッサファミリー Core™ i7-9700E, Core™ i5-9500E, i3-9100E, Core™ i7-9700T, Core™ i5-9500T, Core™ i3-9100T 第8世代インテル® Core™ プロセッサファミリー Core™ i7-8700, Core™ i5-8500, Core™ i3-8100, Core™ i7-8700T, Core™ i5-8500T, Core™ i3-8100T インテル® Pentium® プロセッサファミリー Pentium® G5400, Pentium® G5400T インテル® Celeron® プロセッサファミリー Celeron® G4900, Celeron® G4900T
	搭載数	1
チップセット	インテル® C246	
メモリー	規格	DDR4-2666/2400 MHz SO-DIMM (Un-buffered & Non-ECC) ※Core i3/Pentium/Celeron選択時は、DDR4 2400MHz
	容量	最大64GB
	スロット数	2
ストレージ	2.5" SSD/HDD	2 (フロントアクセス)
	mSATA	3 ※Mini PCI Expressと共有
	RAID	S / W RAID 0, 1, 5, 10
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	シリアル (COM)	4 (RS-232/422/485, 自動フロー制御, 5V/12V, DB9)
	USB	USB3.2 (Gen1)×4 (5Gbps, Type A) USB3.2 (Gen2)×4 (10Gbps, Type A)
	HDMI	1 (4096×2160 @30Hz)
	DisplayPort	1 (4096×2304 @60Hz)
	DVI-I	1 (VGA:1920×1080 @60Hz, DVI-D:1920×1200 @60Hz)
	LAN	2 (インテル® I219-LMとインテル® I210-IT)
	PoE+	※PoE用モジュールが別途必要
拡張スロット	Mini PCI Express	3 (フルサイズ)
	M.2	1 (2230, Key E)
I/O拡張モジュール	MXM	1 (MXM-RTX3000-R10標準搭載。変更可能) NVIDIA Quadro® Embedded RTX3000 MXMキット(1920コア、8GBメモリ、ヒートシンク、サーマルパッド付属)
	CFM (制御機能モジュール)	1
	CMI (I/O拡張用インタフェース)	低速×1、高速×
SIMスロット	2	
オーディオ	Realtek® ALC888 High Definition Audio Line-out×1, Mic-in×1	
アンテナ端子	2	
電源	入力電圧	DC 9~48V
	電源入力タイプ	3-pin電源ターミナルブロック×2
	消費電力	【オプションアダプター】 220Wタイプ (AC/DC 24V/9.2A)
外観寸法 (W×D×H)	260mm × 200mm × 85 mm	
重量	約4.6kg	
取り付け方法	ウォールマウント、VESAマウント可能、DINレールマウント (オプション)、サイドマウント (オプション)	
保護	逆電源入力保護	Yes
	過電圧保護	51~58V
	過電流保護	30A
	ESD(静電気放電)保護	+/- 8kV (空気)、+/- 4kV (接触)
	サージ保護	3.84kV (インピーダンス 12オーム 1.2/50us 波形)
利用環境	動作温度	35W CPU:最大-40°C~+70°C 65W CPU + FAN:-40°C-60°C 80W CPU + FAN:-40°C-55°C
	保存温度	最大-40°C~+85°C
	相対湿度	95% RH @70°C (結露なきこと)
	耐衝撃性	動作時:50Grms、持続時間:11ms (半正弦波)、SSD搭載時、IEC60068-2-27準拠
	耐振動性	動作時:5Grms、5~500Hz、3軸、SSD搭載時、IEC60068-2-64準拠
適合規格	EMC:CE、FCC Class A Railway:EN50121-3-2 Safety: LVD (EN62368-1) In-Vehicle:E-Mark (E13 No.10R-0615566)	
MXM GPU オプションモジュール	MXM-T1000-R10	NVIDIA Quadro® Embedded T1000 MXMキット(896コア、4GBメモリ、ヒートシンク、サーマルパッド付属)
	MXM-P2000-01	NVIDIA Quadro® Embedded P2000 MXMキット(768コア、4GBメモリ、ヒートシンク、サーマルパッド付属)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年3月現在の内容です。

小型な筐体に第10世代Core™を搭載し、 NVIDIA® RTX 30シリーズが搭載可能



画像処理・マシンビジョン向け タイニー型PC
IPC-C470SCQ-SC



- 第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® Q470Eチップセット装備
- NVIDIA® RTX 30シリーズ搭載可能
- USB3.2(Gen2)を計4基装備
- COMポートを2基装備
- 組み込みに適したコンパクトサイズ

✓ 長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセット

生產品質と効率向上を加速させ、長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセットと第10世代インテル® Core™プロセッサを搭載。マルチタスク処理の向上に適したハイパフォーマンス産業用コンピュータを実現。

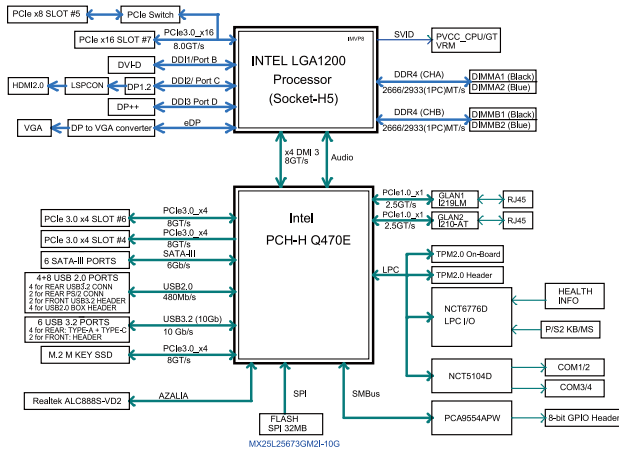
✓ コンパクト筐体ながらオプションでNVIDIA® GeForce RTX 30シリーズを搭載可能

Ampere世代のNVIDIA® GeForce RTX 30シリーズは、マシンビジョン、ディープラーニング、エッジコンピューティング分野で求められる計算負荷が高く並列処理による高速化の実現するGPU。前世代のRTX 20シリーズではGPUメモリが最大11GBのGDDR6だったのに対して、RTX30シリーズでは最大24GBのGDDR6Xと大幅に増強されています。

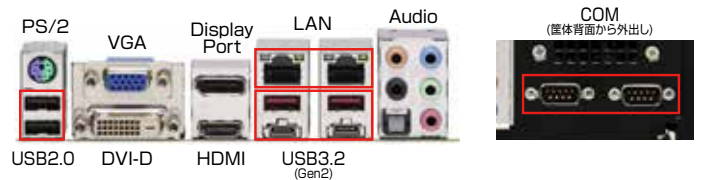
■製品仕様

モデル	IPC-C470SCQ-5C	
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサファミリー ※TDP最大65Wまでのインテル® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサをサポート
	搭載数	1
チップセット	インテル® Q470Eチップセット	
メモリー	規格	DDR4-2933 nECC
	容量	標準16GB (8GB×2) ※最大128GB (32GB×4)
	スロット数	4
ストレージ	3.5インチベイ	2 (空き:1) ※標準:リムーバブルにより2.5インチストレージ×2台搭載可能
ODD	スリム型DVDスーパーマルチドライブ	
GPU	RTX 3060Ti ※オプション RTX 3070 ※オプション RTX3080 ※オプション	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	PS/2	1 (KB/Mouse)
	HDMI	1
	DisplayPort	1
	DVI-D	1
	VGA	1
	シリアル (COM)	2 (筐体背面から外出し)
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA)
	LAN	2 (GbE)
	Audio	6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
拡張スロット	Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0, x16/x8シグナル, CPU側) Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, 4シグナル, PCH側) Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 3.0, Non/x8シグナル, CPU側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, 4シグナル, PCH側)	
外形寸法	スリムシャーシ W136mm × D376mm × H356mm (突起物等を除く)	
重量	約9kg	
電源	850W (連続最大容量 850W) 80 PLUS Gold	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)

■ブロック図



■I/Oポート



■拡張スロット



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL : 03-5446-5535 mail : cto_sales@hpc.co.jp
WEBサイト : <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年4月現在の内容です。